豊富なバリエーションで様々なニーズに対応

Rigid-Flex with wide range of variation possibilities.

Rigid-Flex

Rigid-Flex PCBs

https://www.cmk-corp.com

Features

- コネクタ・ワイヤレスにより、配線板面積が縮小、接触抵抗のロスがなく、また配線長も短くなり、高速信号に対して有効。
- 3次元的設計ができ、製品の小型化が可能
- ワンセット・ワンボード化によりコネクタ、ケーブル等の部品代・組込み代・検査代を含めた、トータルコストの削減が可能。
- フレキ部のインピーダンスコントロール、シミュレーションも対応可能。

- Connector-less and wireless structure reducing wiring board area, contact resistance, wiring length and therefore suitable for high-speed signal.
- 3D design is possible and contributes to the miniaturization of a product.
- "One set and One board" makes it possible to cut overall cost containg components, assembly cost, inspection cost and so on.
- Impedance control of flex part and simulation is also available.

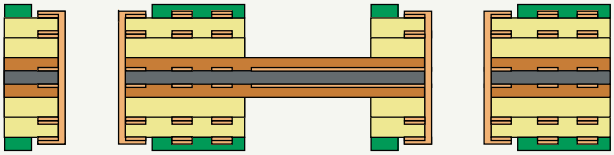
Structure

■貫通仕様　RF-1（Thickness:0.55～1.00mm）

Through-hole structure (Thickness : 0.55～1.00mm)

6層RF-1タイプ（6layer RF-1）

6 layer RF-1



■ラインナップLine up Rigid-Flex PCBs

	BU層	TH	BVH 外層 outer layer	BVH 内層 inner layer	BH	層構成
RF-1		○				4～8層
RF-3-S	一段	○	○			6、8層
RF-3-D	二段	○	○	○		8層
RF-3-SB	一段	○	○		○	6、8層
RF-3-DB	二段	○	○	○	○	8層

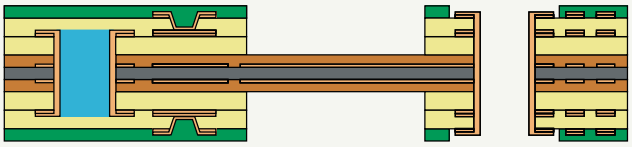
○：対応可能　○ Correspondence

■1段ビルドアップ　RF-3-SB（Thickness:0.6～1.0mm）

Single build-up structure (Thckness : 0.6～1.0mm)

6層RF-3-SBタイプ（6layer RF-3-SB）

6 layer RF-3-SB

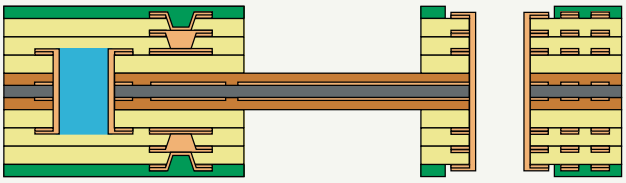


■2段ビルドアップ　RF-3-DB (Thickness : ~0.95mm)

Double build-up structure (Thickness : ～0.95mm)

8層RF-3-DBタイプ(8layer RF-3-DB)／BVH stacked

8 layer RF-3-DB



Application

■　高板厚リジッド･フレックス　Thick RF

“リジッド・フレックス配線板にしたいが、板厚も欲しい”

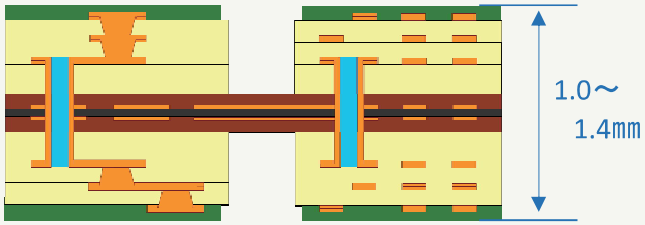
※適用板厚 thickness　：　1.0 ＜ t ≦ 1.4㎜

If you want to thicken the board with RF

【温度サイクル試験】Temperature cycle test

－40℃／30min⇔105℃／30min　1000cyc　OK

■8層RF-3-DB（2-4-2）　8 layer RF-3-DB (2-4-2)



記載内容は予告なく変更する場合があります。
The contents are subject to change without notice.
2026.01